

開発中 PR商品

Epochcluster Coolie

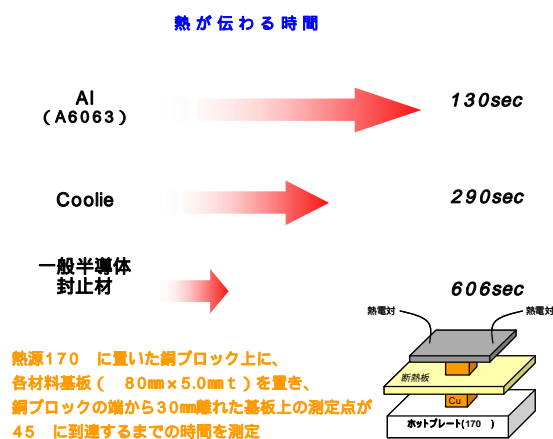
エポクラスタールーリエ

絶縁高熱伝導性エポキシ複合材料

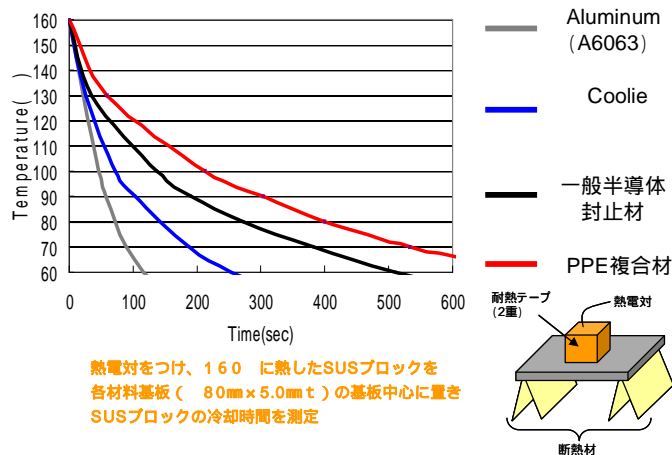
- ・熱伝導率がエポキシ樹脂の30倍 熱伝導率 $6\text{ W/m}\cdot\text{K}$
- ・電気絶縁性が良好 比抵抗 $1.6 \times 10^{16} \cdot \text{cm}$ 絶縁破壊強さ 12 kV/mm
- ・射出成形が可能 トランスファー成形にも対応可能
- ・線膨張係数が小さい 17 ppm ($1.7 \times 10^{-5}/\text{K}$)
- ・お客様のご用途によりカスタマイズ 本材料は開発ベースの一例でありお客様用途にカスタマイズ

Cool

熱伝導性



熱体冷却性

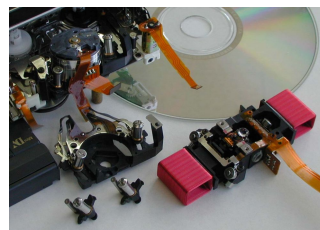


Injection

絶縁高熱伝導な精密部品が
生産性の高い射出成形により対応可能

Application

- ・LED照明部品
- ・高出力レーザ部品
- ・パワーデバイス半導体封止材料
- ・コイル封止材料
- ・モーター部品
- ・自動車関連部品
- ・電子部品 全般 etc.



Epochcluster Coolie

Properties

エポクラスタールーリーエ

特性	試験方法	単位	エポクラスタールーリーエ
			CC06
熱伝導率	定常法-熱流計法	W/m ² ·K	6.0
粘度	175、高化式 FT	Pa·s	145
引っ張り強さ	ISO527-1.2	MPa	30
引っ張りひずみ	ISO527-1.2	%	0.40
曲げ強さ	ISO178	MPa	53
曲げ弾性率	ISO178	MPa	30100
成形収縮率		(MD/TD)%	0.27 / 0.24
シャルピー衝撃	ISO179-1.2	k J/m ²	1.9
比熱	JIS K7123	J/kg·K	764
荷重たわみ温度	ISO75-1.2		> 280
線膨張率	ISO11359-2	10 ⁻⁵ /K	1.7
燃焼性	UL94		HB相当
比抵抗	IEC60093	·cm	1.6 × 10 ¹⁶
絶縁破壊強さ	短時間昇圧法	kV/mm	12
誘電率	容量法		7.3
比重	ISO1183		3.05
吸水率	JISK7209	%	0.02

Molding condition

	射出成形	トランスファー成形
材料保存	冷凍保存推奨	
シリンダー温度	80 ~ 100	ダブレット 90 ~ 100
金型温度	160 ~ 190	160 ~ 190
成形圧力	~ 185MPa	~ 100MPa
充填速度	~ 30cc/sec	~ 20cc/sec
充填時間	2 ~ 6sec	5 ~ 15sec
硬化時間	30sec ~	80sec ~

クラスタールーロジー 株式会社

営業・マーケティング本部

本社 〒577-0836 大阪府東大阪市洪川町4-5-28

TEL: 06-6726-2711 FAX: 06-6726-2715

e-mail: osaka-tech@cluster-tech.co.jp

東京営業所 〒103-0001 東京都中央区日本橋小伝馬町16-5

新日本橋長岡ビル 3階

TEL: 03-5642-6183 FAX: 03-5642-6185

URL: <http://www.cluster-tech.co.jp>

